低エネルギー電子線照射が Al-doped 4H-SiC

薄膜中のアクセプタヘ与える影響

E-01010 伊藤 裕司 松浦研究室

[背景・目的] SiCは耐放射線性に優れた半導体材料として注目されている。これまで、Al-doped 4H-SiC薄 膜への電子線照射によって正孔密度が減少すると報告してきた¹⁾。その理由として、{1}格子位置にある Al原子が弾かれ、Alがアクセプタとして働かなくなった、{2}Alに隣接するC原子が弾かれてAl原子との 結合が切れ、Alがアクセプタとして働かなくなった等が挙げられるが未だ同定されていない。軽原子ほど 低い電子線照射エネルギーで弾かれることから、適切な電子線照射エネルギーを選択することで、対象原 子を選択的に弾くことが可能であると考えられる。Si、Al、Cの中で最も軽いC原子を電子線照射によって 選択的に弾き、SiC薄膜中のアクセプタ密度の変化から、正孔密度減少の起源について調べる。

[実験方法] 1 cm角のn型 4H-SiC基板上にエピタキシャル成長させた p型 Al-doped 4H-SiC 薄膜 (膜厚 10 μm)の表面四隅にTi/Alオーミック電極を形成した。照射エネルギー 200 keV(照射量 1×10¹⁶ cm⁻²)、500 keV(照射量 5×10¹⁵ cm⁻²)の各エネルギーで試料へ電子線を照射した。それぞれの試料の照射前後で、van der Pauw法によるホール効果測定を行った。

[実験結果・考察] 図1に Al-doped 4H-SiC 薄膜の正孔密度の温度依存性を示す。図1から正孔密度が未 照射と比べ 200 keV の電子線照射では少し減少し、500 keV の電子線照射では大幅に減少したことがわか る。

Free carrier concentration spectroscopy(FCCS法)による、Al-doped 4H-SiC薄膜中のアクセプタ密度、 準位の解析結果を表1に示す。Alのアクセプタ準位は191 meVとの報告²⁾があり、200 meV付近はAlのア クセプタ準位と考えられる。200 keVの電子線照射によって主に弾かれる原子はC原子である。このことか

ら、200 keVの電子線照射ではAlに隣接するC原子 が弾かれた為にAlのアクセプタ密度が減少したと 考えられる。

電子線照射によりC原子が弾かれ、C空孔(Ve)は 増加すると考えられ、深いアクセプタ準位の密度が 電子線照射によって増加していることから深いア クセプタ準位にはVeが関係していると考えられる。 Alsi-Veが深いアクセプタ準位を形成するという報 告がある(準位は不明)ことから350 meV付近の深 いアクセプタ準位はAlsi-Veアクセプタによるもの であると考えられる。

500 keV の電子線照射では、深いアクセプタ準 位のみを見積もることができ、電子線照射によりア クセプタ密度が減少していることがわかる。500 keV の電子線照射では、Si、Al、C 全てが弾かれ るので、これらの原子で構成されたアクセプタ密度 が減少したと考えられる。

[結論] 200 keVの電子線照射による正孔密度の減 少は照射によりC原子が弾かれ、Alがアクセプタと して働かなくなった為であることが分かった。同定 されていないAl-doped 4H-SiC 薄膜中の深いアク セプタ準位は、Al_{si}-V_cアクセプタであると考えられ る。

[謝辞] 電子線照射をして戴いた日本原子力研究所 高崎研究所の方々に深く感謝いたします。

[参考文献]1)H.Matsuura et al:Apple.Phys.Lett., 83(2003)p.4981.

2)G.L.Harris:Properties Of Silicon Carbide,13

(INSPEC,London,1995)p.88



図1 正孔密度の温度依存性

表1 FCCS 解析結果

	未照射	200 keV	500 keV
<i>N</i> _{A1} [cm ⁻³]	5.34×10^{15}	4.34×10^{15}	$\sim 2.7 \times 10^{14}$
$E_{\rm A1}[{ m meV}]$	205	218	_
N _{A2} [cm ⁻³]	3.77×10^{15}	5.38×10^{15}	1.54×10^{15}
$E_{ m A2}[m meV]$	371	374	358